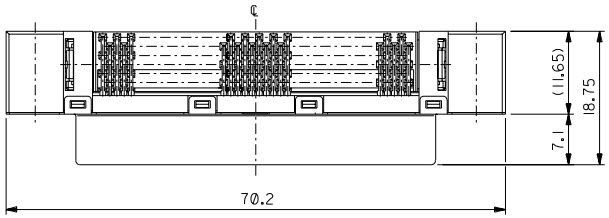
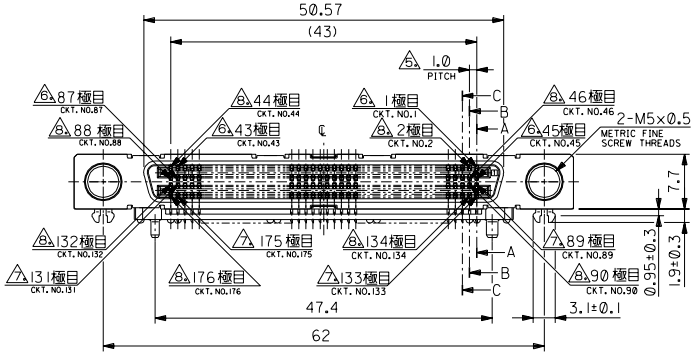
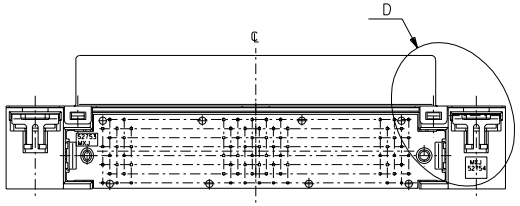
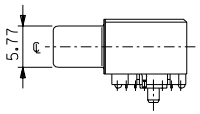
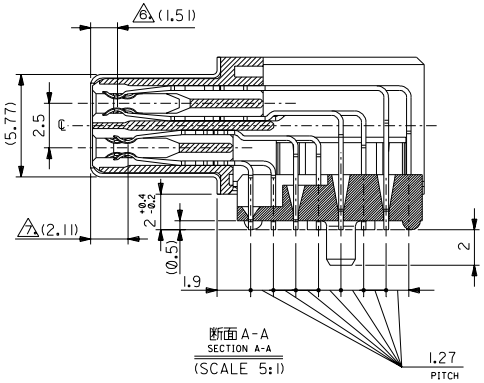
DWG. NO. SD-52755-003



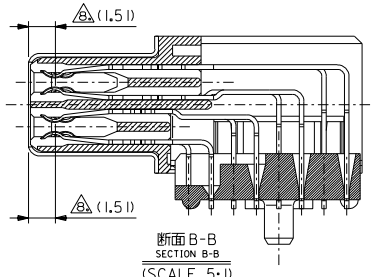




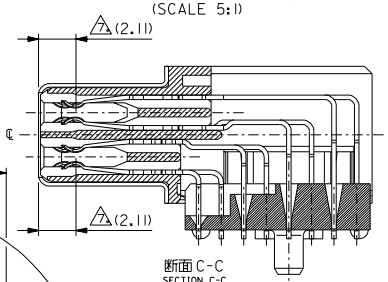




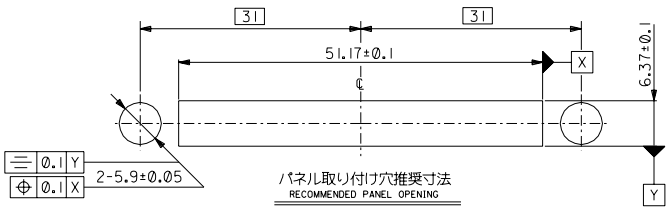
断面 A-A
SECTION A-A
(SCALE 5:1)



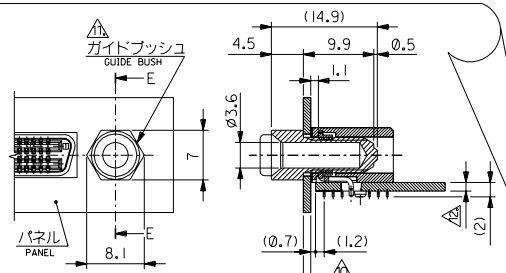
断面 B-B
SECTION B-B
(SCALE 5:1)



断面 C-C
SECTION C-C
(SCALE 5:1)

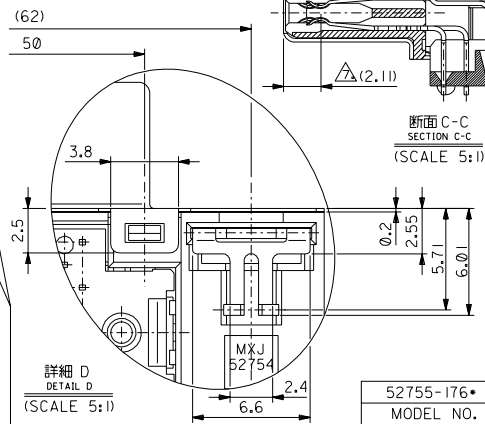


パネル取り付け穴推奨寸法
RECOMMENDED PANEL OPENING

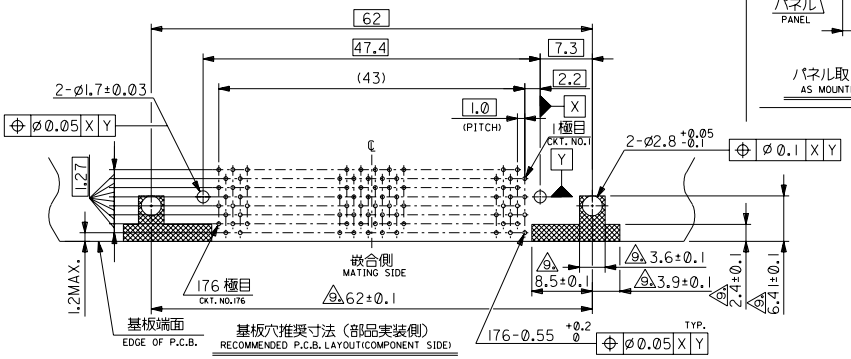


パネル取り付け状態
AS MOUNTED ON PANEL

断面 E-E
SECTION E-E



詳細 D
DETAIL D
(SCALE 5:1)



基板端面
EDGE OF P.C.B.

基板穴推奨寸法（部品実装側）
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT(COMPONENT SIDE)

注）NOTES

1. 材質 MATERIAL
   - ハウジング HOUSING ：ガラス入り耐熱樹脂、白色、UL94V-0 ; G.F.HEAT RESISTANT PLASTIC,WHITE,UL94V-0
   - ガイドプレート GUIDE PLATE ：ガラス入り耐熱樹脂、白色、UL94V-0 ; G.F.HEAT RESISTANT PLASTIC,WHITE,UL94V-0
   - ターミナル TERMINAL ：りん青銅 ; PHOSPHOR BRONZE
   - シールドカバー SHIELD COVER ：鋼材 ; STEEL
   - メタル ペグ METAL PEG ：鋼材 ; STEEL
2. ターミナル メッキ仕様 TERMINAL PLATING
   - 金メッキ GOLD ：0.76 μm MIN. （接点部 CONTACT AREA）
   - 錫メッキ TIN ：1.0 μm MIN. （半田付け部 SOLDER AREA）
   - ニッケルメッキ NICKEL ：2.0 μm MIN. （下地メッキ UNDER PLATING）
3. シールド メッキ仕様 SHIELD COVER PLATING
   - ニッケルメッキ NICKEL ：2.0 μm MIN.
4. メタルペグ メッキ仕様 METAL PEG PLATING
   - 錫メッキ TIN ：1.0 μm MIN.
   - ニッケルメッキ NICKEL ：2.0 μm MIN. （中間メッキ OVER COPPER）
   - 銅メッキ COPPER ：1.0 μm MIN. （下地メッキ UNDER PLATING）

5 公差非累積 TOLERANCES : NON CUMULATIVE

6 1、43、45、87 極目に適用。 APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 1,43,45,87.

7 奇数極に適用。但し、1、43、45、87 極目を除く。 APPLIES TO ODD CIRCUITS EXCEPT CIRCUIT NUMBERS 1,43,45,87.

8 偶数極に適用。 APPLIES TO EVEN CIRCUIT NUMBERS

9 パターン禁止エリア（2ケ所） NO FOOT PRINT TO BE DRAWN IN THESE TWO AREAS.

10 取り付けパネル厚さ 0.4～1.0 mm RECOMMENDED PANEL THICKNESS

11 パネル取り付け専用パーツ型番：58001-0000 PART NUMBER OF PANEL MOUNTING FASTENER : 58001-0000
（詳細はモレックス図番 SD-58001-0000 を参照下さい。 REFER TO THE DRAWING NO.SD-58001-0000 ON DETAILS.）

12 取り付け基板厚さ 0.8 ～ 1.4mm RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS

13.本製品は 52755-1760 の鉛フリー品である。 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52755-1760.

52755-176* MODEL NO.	52755-1769 MATERIAL NO.

角度 ANGLE	±3°				
30 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.3				
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25				
10 未満 UNDER	±0.2	0	新規作成 RELEASED (J2004-4288)	K.T '04/05/18	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '04/05/18	H.KAWABATA
CHK'D BY '04/05/18	K.TOJO
APP'D BY '04/05/18	M.SASAO
尺度 SCALE	2 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.0mm I/O DOCKING CONN. REC. ASS'Y (GUIDE BUSH TYPE) -LEAD FREE-

DWG. NO. SD-52755-003 REV 0

SD-52755-003.SO1 A

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-31